

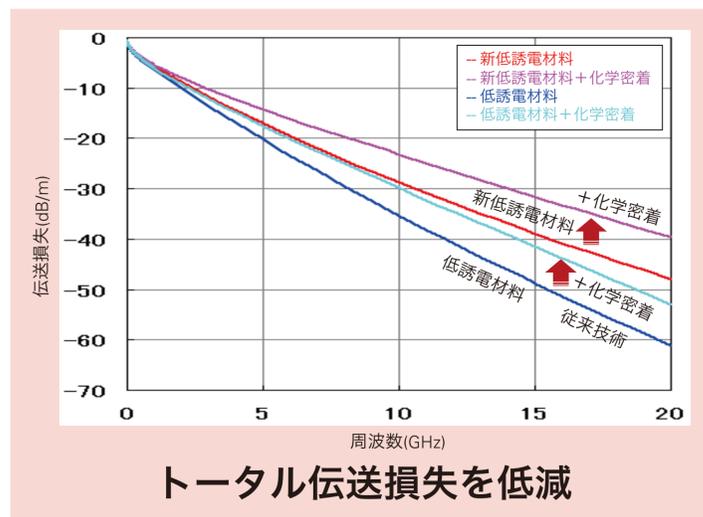
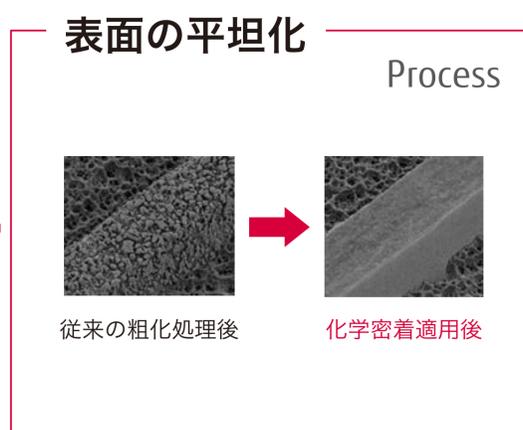
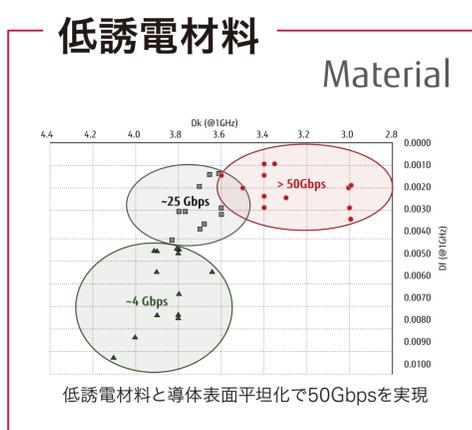
超高速伝送・超高多層基板

Ultra-High-Speed and Ultra-High-Layer PCBs

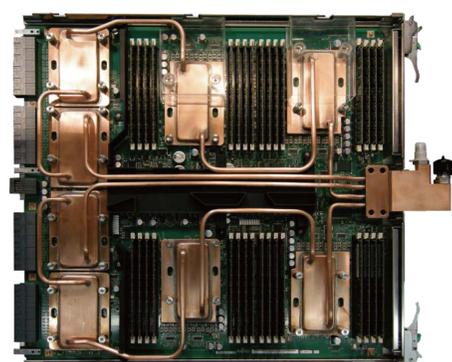
スーパーコンピュータ、5Gインフラ、高性能HPC*向け基板

*... High Performance Computing

■ Low-loss Materialsの採用と伝送ロス低減



■ 世界最高水準：スーパーコンピュータへの貢献



CPU 6.3Gbps



スーパーコンピュータ「京」



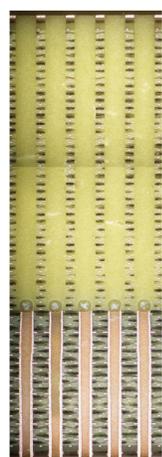
CMU 28Gbps



スーパーコンピュータ「富岳」

高速伝送材料と配線構造を駆使した基板技術によって世界一に貢献

■ 超高多層への挑戦



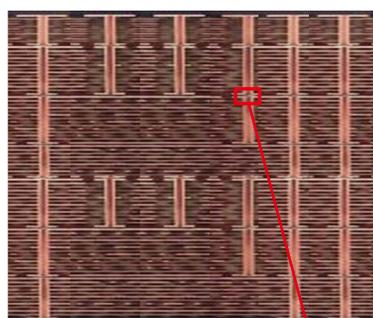
AR38 (Back Drill)



AR38



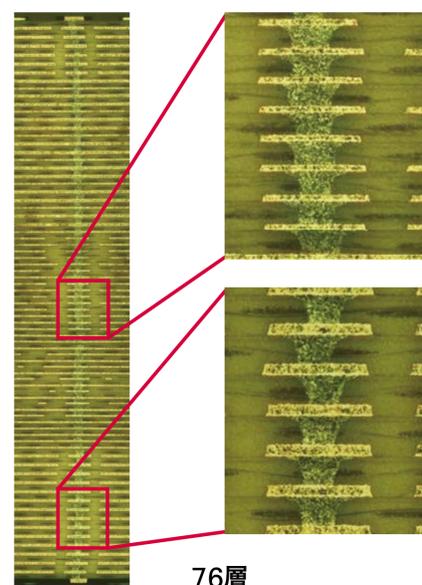
AR49



AR62



Board to board connection by conductive paste



76層

ドリル技術およびF-ALCS技術(全層IVH)で超高アスペクトを実現

